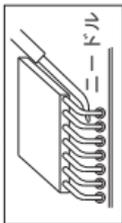
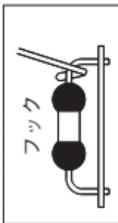


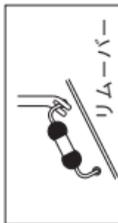
■使用方法



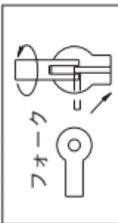
ICなど取り外す時に使います。はんだこてではんだを溶かしながらリードICのリードを浮かせて取り外します。



はんだこてではんだを溶かしながら、基板に取り付けられた電子部品を取り除くのに使用します。



抵抗、コンデンサ、ICの取外し時にはんだこてではんだを溶かしながら、リード線をつかみ、取り外します。



抵抗など電子部品のリード線をパターン方向に曲げたりする為に使います。



はんだカスや基板のマスキングの除去及びサビ取りに使用します。



リード線の皮膜除去、基板のマスキング除去及びサビ取り等に使用します。



⚠警告

●刃物等、先端が鋭いものが含まれておりますのでご使用の際には、十分ご注意ください。

■特長

チップ部品、アクセサリ部品、ラジアル部品の取付け時、取外し時の研磨、クリーニング等にご使用できます。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

© 2004-2019 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

MADE IN CHINA

2019.11
MA01298XZ191119